

2017年9月13日から15日まで台湾の台北世界貿易中心にて開催される「SEMICON Taiwan 2017」に出展します。

展示会当日は、新製品ラインアップを展示し、実機によるデモンストレーションも行います。

ご来場の際には是非とも当社ブースにお立ちよりくださいますよう、お願い申し上げます。

展示会開催中は下記の製品をご紹介します。

開催期間	2017年9月13日(水)～15日(金) 10:00～17:00 (15日(金)のみ16:00終了)
会場	Taipei Nangang Exhibition Center, Taiwan
当社ブース	TWTC Nangang Hall (4 F) No.316
交通アクセス	<a href="http://www.twtcnangang.com.tw/zh-tw/transportation">http://www.twtcnangang.com.tw/zh-tw/transportation</a>
出展機種	12-inch SiP Die Bonder <b>BESTEM-D531t</b> 
本展示会・製品に関するお問い合わせ： キヤノンマシナリー株式会社 セミコンシステム事業本部 営業部 Tel : 077-566-1822 Fax : 077-566-1833 E-Mail : sales-ml@canon-machinery.co.jp	